

## 3D Wirebonder

Der erste um die Ecke Drahtbonder

<b>Programm / Ausschreibung</b>	IWI 24/26, IWI 24/26, Basisprogramm Ausschreibung 2025	<b>Status</b>	laufend
<b>Projektstart</b>	04.03.2025	<b>Projektende</b>	03.09.2026
<b>Zeitraum</b>	2025 - 2026	<b>Projektlaufzeit</b>	19 Monate
<b>Keywords</b>			

### Projektbeschreibung

Das Ziel dieses Innovationsprojekts ist es einen funktionsfähigen 3D Wirebonder für Dünndrahtapplikationen zu entwickeln. Dafür soll zusätzlich zu den bestehenden Verfahrensmöglichkeiten eine weitere Rotations- und Verkippungsachse des Bauteilhalters realisiert und alle miteinander synchronisiert werden.

### Endberichtkurzfassung

Im Rahmen dieses Innovationsprojekts wurde erfolgreich ein funktionsfähiger 3D Wirebonder für Dünndrahtapplikationen entwickelt. Dafür wurde zusätzlich zu den bestehenden Verfahrensmöglichkeiten eine weitere Rotations- und Verkippungsachse des Bauteilhalters realisiert und mit den bestehenden Achsen synchronisiert. Die Funktionsfähigkeit wurde anhand eines realistischen Demonstrators erfolgreich erprobt.

### Projektpartner

- F&S BONDTEC Semiconductor GmbH